



MYD-JX8MMA7 产品介绍

版本: V1.0

日期: 2022年10月12日



版本历史

版本	作者	参与者	日期	备注
V1.0	米尔产品部		20221012	初版

说明:本文档及涉及到的产品相关参数仍存在潜在变动可能,最终产品以最终发布时版本 为准



目录

1	.产品介绍	1
2	.主芯片介绍	3
3	. MYC-JX8MMA7 核心板	5
	3.1.核心板外观图	5
	3.2.核心板系统框图	6
	3.3.核心板资源及参数	7
	3.4.核心板扩展信号	8
	3.5.核心板机械结构图	9
4	. MYB-JX8MMA7 底板	.10
	4.1.开发板系统框图	. 12
	4.2.底板外设接口资源	. 13
	4.3.底板机械尺寸图	. 14
5	软件资源	.15
	5.1. Linux 系统镜像文件	. 15
	5.2.FPGA 工程文件	. 15
	5.3.基于 QT5 的 HMI V2.0 系统	. 15
	5.4.丰富的 Linux 系统资源	. 16
6	.产品配置及选配	.17
	6.1.核心板配置型号	. 17
	6.2.开发板配置型号	. 17
	6.3.开发板包装清单	. 18
	6.4. 选配档也	12



1.产品介绍

ARM+FPGA 是一种主流的嵌入式系统的处理架构。相对于单纯 ARM 开发或者单纯 FPGA 开发,ARM+FPGA 架构能带来性能、成本、功耗等组合优势。两者各司其职,各 自发挥原本架构的独特优势。ARM 接口资源丰富、功耗低,擅长进行多媒体显示、逻辑 控制等; FPGA 擅长进行多通道或高速 AD 采集、接口拓展,以及高速信号传输等。ARM 与 FPGA 通过高速通信 PCIE 接口快速进行数据通信,可以用于医疗,电力通信,工业控 制等行业。

米尔科技基于 NXP i.MX8M Mini 及 XILINX ARTIX A7 系列芯片作为主处理器推出了 全新的开发套件 MYD-JX8MMA7, 套件由核心板 MYC-JX8MMA 和底板 MYB-JX8MMA 组成,核心板与底板采用金手指连接方式。随同开发套件 MYIR 提供了丰富的软件资源以 及文档资料。软件资料包含但不限于 U-boot、Linux、所有外设驱动源码和相关开发工 具。文档资料包含产品手册、硬件用户手册、硬件设计指南、底板 PDF 原理图、Linux 软 件评估和开发指南等相关资料。MYIR 旨在为开发者提供稳定的参考设计和完善的软件开 发环境,能够有效帮助开发者提高开发效率、缩短开发周期、优化设计质量、加快产品研 发和上市时间。



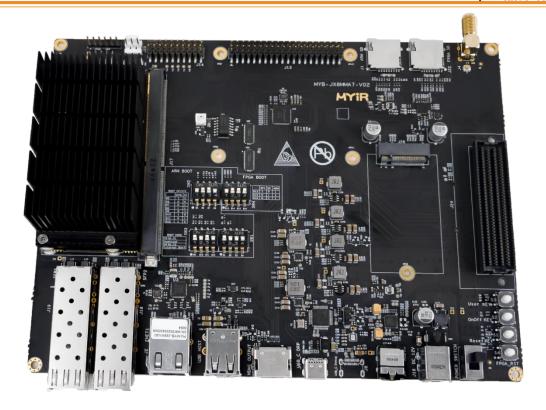


图 1-1 MYD-JX8MMA7 开发板正面

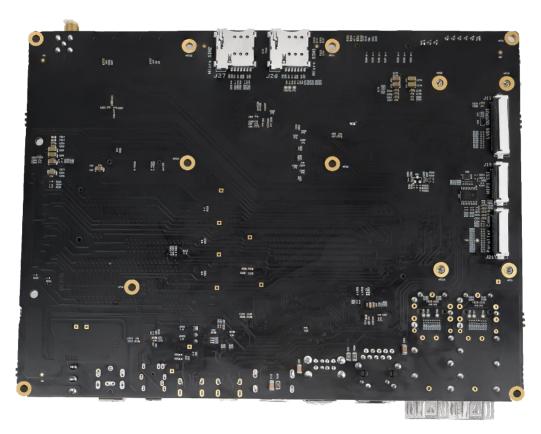


图 1-2 MYD-JX8MMA7 开发板背面



2.主芯片介绍

i.MX 8M Mini 系列集成了高性能 Cortex-A53+Cortex-M4 处理器,处理器运行速度最高达 1.8GHz,支持 16/32 位 LPDDR4 / DDR4/ DDR3L。内部集成了电源管理、安全单元和丰富的互联接口,具有高性能、低功耗、灵活的内存选项和高速接口以及业界领先的音视频功能。为物联网应用提供了一种安全、高性能的解决方案。

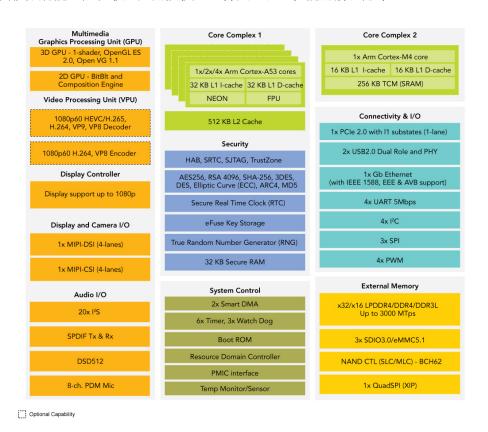


图 2-1 i.MX 8M Mini 系列处理器框图

Artix-7 系列器件是 Xilinx 公司推出的单个成本优化的 FPGA,此系列的 FPGA 芯片提供了最高性能功耗比结构、高速收发器、DSP 处理能力,包含 MicroBlaze 软处理器和对 DDR3 的支持。因此 Artix-7 系列 FPGA 具有开发周期短、灵活性高、并行计算效率高、高性能、低功耗等优势,所以广泛用于通信、消费电子、工业控制以及嵌入式等领域。



温度的差异。

MYC-JX8MMA7 核心板中 FPGA 采用的是 ARTIX-7 系列的 XC7A25T-2CSG325 芯 片,主要用到了商业级和工业级两种型号,两种型号的芯片核心无差异,主要是芯片工作

Artix-7 XC7A25T	参数
Logic Cells	23,360
Slices	3,650
CLB Flip-Flops	29,200
Maximum Distributed RAM (Kb)	313
Block RAM/FIFO w/ ECC (36 Kb each)	45
Total Block RAM (Kb)	1,620
CMTs (1 MMCM + 1 PLL)	3
Maximum Single-Ended I/O	150
Maximum Differential I/O Pairs	72
DSP Slices	80
Analog Mixed Signal (AMS) / XADC	1
Configuration AES / HMAC Blocks	1
GTP Transceivers (6.6 Gb/s Max Rate)	4

表 2-1 Artix-7 XC7A25T 主要特性



3. MYC-JX8MMA7 核心板

MYC-JX8MMA7 核心板采用高密度高速电路板设计,在大小为 82mmx45mm 的板 卡上集成了 ARM i.MX8M Mini、LPDDR4、eMMC、FPGA ARTIX 7、DDR3、QSPI、 PMIC 电源管理等电路。

3.1.核心板外观图



图 3-1 核心板 MYC-JX8MMA7 正面图

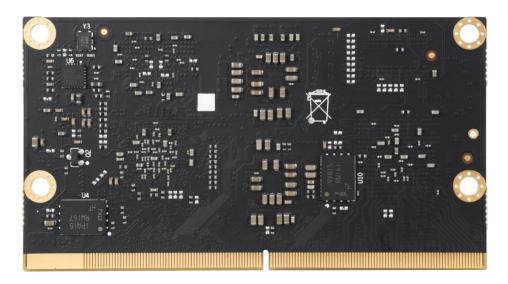


图 3-2 核心板 MYC-JX8MMA7 背面图



3.2.核心板系统框图

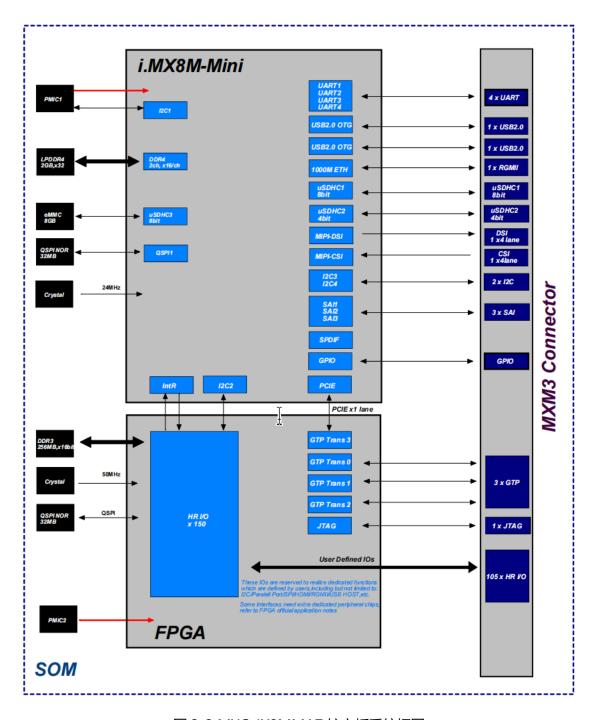


图 3-3 MYC-JX8MMA7 核心板系统框图



3.3.核心板资源及参数

名称	主要参数
主控芯片系列	ARM: i.MX 8M Mini Quad FPGA: ARTIX7
主控芯片型号	ARM: MIMX8MM6CVTKZAA (标准配置) MIMX8MM6DVTLZAA (标准配置) FPGA: XC7A25T-2CSG325I (标准配置) XC7A25T-2CSG325C (标准配置)
内存	ARM LPDDR4: 2GB FPGA DDR3: 256MB
存储器	ARM eMMC : 8GB FPGA QSPI Flash: 32MB
其它存储器	ARM QSPI Flash: 32MB
ARM 处理器规格	x4 Cortex-A53、Cortex-M4、GPU、VPU
FPGA Logic Cells	23360
FPGA DSP Slice	80
FPGA GTP	4
核心板尺寸	82mmx45mm
接口类型	使用 314pin,金手指连接器
PCB 板规格	10 层板设计,沉金工艺生产
操作系统	Linux 5.10.72

表 3-1 MYC-JX8MMA7 核心板资源及参数列表



3.4.核心板扩展信号

MYC-JX8MMA7核心板通过金手指引出信号和电源地共计314PIN,这些信号引脚包

含了丰富的外设资源,具体请查看下表:

项目	参数	
ARM 资源		
Ethernet	1*RGMII	
USB2.0	2* USB2.0	
Camera	1* MIPI CSI	
SDIO	2*SDIO	
UART	4*UART	
I2C	2*I2C	
SPI	3*SPI	
Display Output	1*MIPI-DSI	
Audio	3* I2S	
	FPGA 资源	
GTP	3	
Logic Cells	23360	
Slices	3,650	
CLB Flip- Flops	29,200	
DSP Slices	80	

表 3-2 MYC-JX8MMA7 核心板扩展信号资源列表

注:以上资源为最大资源,可能存在接口复用的情况



3.5.核心板机械结构图

核心板工艺: 82*45mm, 板卡采用 10 层高密度 PCB 设计, 沉金工艺生产, 独立的 接地信号层,无铅。核心板和底板采用金手指连接器连接。核心板金手指规格为 314PIN MXM3.0 规格的通用金手指,底板需要使用相应的金手指连接器,型号为 AS0B821-S78B-7H, 品牌 Foxconn。

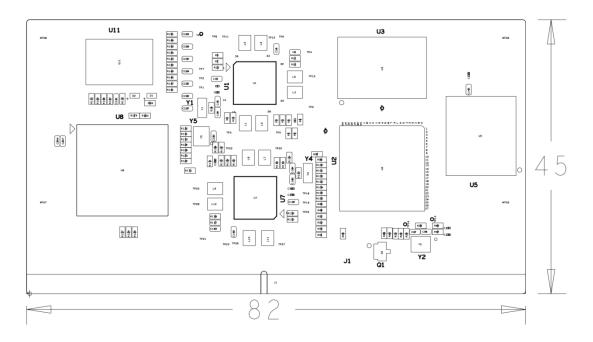


图 3-4 MYC-JX8MMA7 核心板机械结构图 (单位: mm)



4. MYB-JX8MMA7 底板

MYB-JX8MMA7 是与 MYC-JX8MMA7 核心板配套使用的扩展底板,采用 12V/2A 直流供电, 搭载了1路干兆以太网接口、2路SFP光模块接口、1路USB2.0协议M.2B 型插座的 5G 模块接口、1路 SDIO/串口协议的 WIFI/蓝牙接口、1路 HDMI 显示接口、1 路 LVDS 显示接口、1路 MIPI CSI 接口、1路 DVP 摄像头接口、1路音频输入输出接 口、2 路 USB HOST Type A、1 路 USB Type-C、2 路 Micro SD、1 路 FMC 扩展接口、 1 路兼容树莓派扩展模块接口。

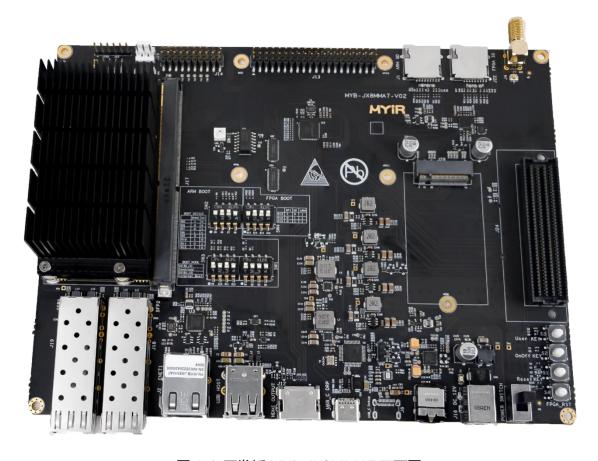


图 4-1 开发板 MYD-JX8MMA7 正面图



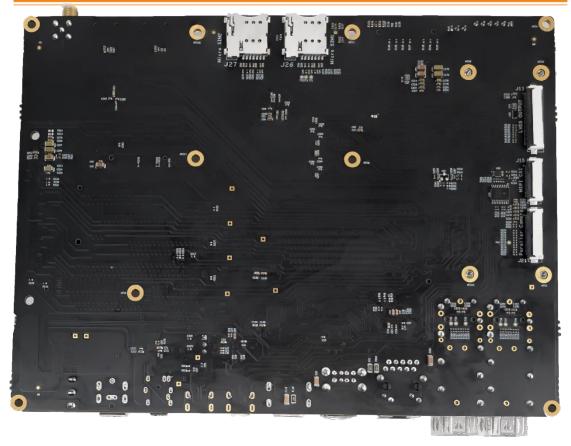


图 4-2 开发板 MYD-JX8MMA7 背面图



4.1.开发板系统框图

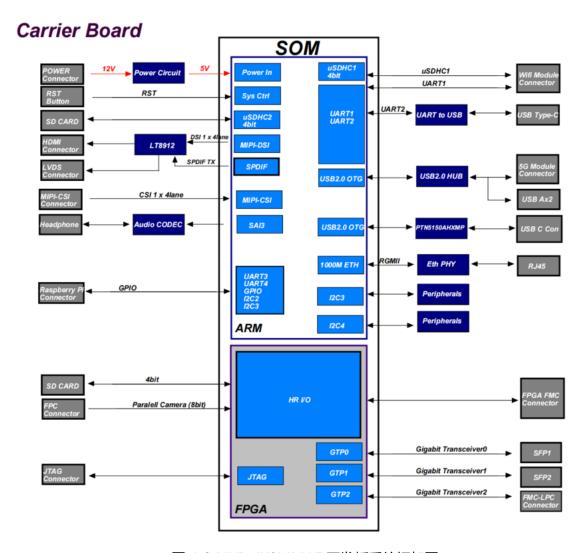


图 4-3 MYD-JX8MMA7 开发板系统框架图



4.2.底板外设接口资源

功能		参数	
	POWER	12V/2A, DC JACK	
	KEY	2 路复位按键、1 路用户按键、1 路 ON/OFF 按键	
系统	BOOT SET	1路 ARM BOOT、1路 FPGA BOOT	
	SD	2 路 Micro SD 卡槽	
	DEBUG	1路 ARM 调试串口,1路 FPGA JTAG 调试接口	
	WIFI/BT	1路 WIFI/BT 模块接口	
	5G/4G	1 路 M.2 B 型插座 5G 模块接口	
	Ethernet	1 路 10/100/1000M 以太网接口,RJ45 接口	
通讯接口	SFP	2 路 SFP 光模块接口	
	USB	2路 USB 2.0 HOST 接口,采用 Type-A 接口	
		1路 USB 2.0 OTG 接口,采用 Type-C 接口	
	UART	2 路串口通过扩展排针引出	
	DISPLAY	1路 LVDS 显示接口	
		1 路 HDMI 显示接口	
多媒体接口	CAMERA	1路 MIPI CSI 摄像头接口	
		1 路 DVP 摄像头接口	
	AUDIO	1 路音频输入输出接口	
扩展接口	RPI	1 路 2*20 Pin 排针接口,GPIO/I2C/SAI/UART	

表 4-1 MYB-JX8MMA7 外设接口资源列表



4.3.底板机械尺寸图

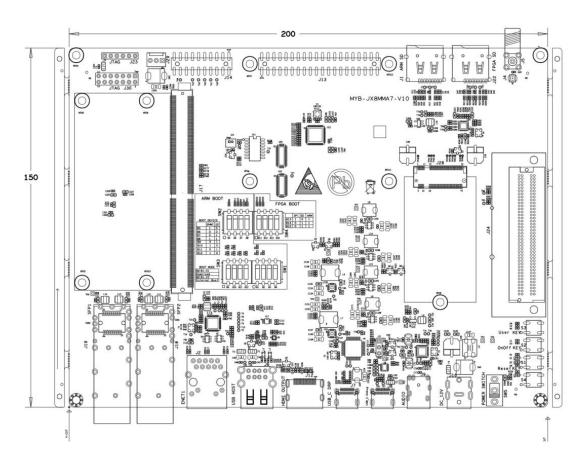


图 4-4 MYB-JX8MMA7 机械尺寸图 (单位: mm)



5.软件资源

MYD-JX8MMA7 提供丰富的软件资源以帮助客人尽快实现产品的开发。在产品发布 时,您可以获取全部的 Linux BSP 源码及丰富的软件开发手册。

5.1. Linux 系统镜像文件

- myir-image-full: 以 yocto 构建的有 GUI 界面的镜像, 支持带有 QT5.12.5 库的 MEasy-HMI V2.0 系统
- myir-image-core:以 Yocto 构建的没有 QT 的镜像,包含完整的硬件驱动,常 用的系统工具,调试工具等

5.2.FPGA 工程文件

- MYIR PCIE 5T CMOS.rar: 摄像头输出视频通过 PCIE 传输到 ARM 端,通过 HDMI 接口进行显示
- MYIR PCIE 5T SD.rar: SD 卡里的图片通过 PCIE 传输到 ARM 端,通过 HDMI 接口进行显示
 - MYIR SFP.rar: SFP 光口回环测试

5.3.基于 QT5 的 HMI V2.0 系统

MEasy HMI V2.0 是深圳市米尔科技有限公司开发的一套基于 QT5 的人机界面框架。 项目采用 QML 与 C++混合编程,使用 QML 高效便捷地构建 UI,而 C++则用来实现业 务逻辑和复杂算法。根据应用的类型我们将整个 UI 分为五个大类: 多媒体, 智能家电, 卫



生医疗,公共服务,系统设置。每个类下面又包含不同小类,针对每个小类我们实现了相 应的应用。

5.4.丰富的 Linux 系统资源

类别	名称	描述信息	源码
Bootloader	U-boot	引导启动程序 U-boot 2021.04	YES
Linux 内核	Linux kernel	基于官方 kernel_5.10.72 版本定制	YES
	ММС	eSDHC 驱动程序	YES
	SPI	SPI 驱动程序	YES
	I2C	i2c 驱动程序	YES
	USB Host	USB 驱动程序	YES
	Ethernet	干兆网络驱动程序	YES
	USB OTG	USB 驱动程序	YES
\D. (** 355 - *	UART	串口驱动程序	YES
设备驱动	GPIO key	Key 驱动程序	YES
	Wifi&bt	Brcm 驱动程序	YES
	RTC	RTC 驱动程序	YES
	Gpio Led	Led 驱动程序	YES
	MIPI DSI	Mipi 驱动程序	YES
	CSI	CSI 驱动程序	YES
	Touch	触摸屏驱动程序	YES
- W - 7/-	myir-image-full	以 Yocto 构建的有 GUI 界面的文件系统	YES
文件系统	myir-image-core	以 Yocto 构建的没有 QT 的文件系统	YES

表 5-1 Linux 系统资源列表



6.产品配置及选配

MYC-JX8MMA7 系列核心板包含 2 种标准产品型号:它们在工作温度参数方面有一

些差异,客户可根据需求自行选择合适的型号

6.1.核心板配置型号

产品型号	MYC-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-160-I	MYC-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-180-C
	ARM: MIMX8MM6CVTKZAA	ARM: MIMX8MM6DVTLZAA
主芯片	FPGA: XC7A25T-2CSG325I	FPGA: XC7A25T-2CSG325C
内存	ARM LPDDR4: 2GB	ARM LPDDR4: 2GB
	FPGA DDR3: 256MB	FPGA DDR3: 256MB
≠₩₽₽	ARM eMMC : 8GB	ARM eMMC : 8GB
存储器	FPGA QSPI Flash: 32MB	FPGA QSPI Flash: 32MB
工作温度	-40°C~+85°C	0°C ~ +70°C

表 6-1 MYC-JX8MMA7 核心板选型表

6.2.开发板配置型号

产品型号	MYD-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-160-I	MYD-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-180-C
对应核心 板型号	MYC-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-160-I	MYC-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-180-C
工作温度	-40℃~+85℃	0℃ ~ +70℃

表 6-2 MYD-JX8MMA7 开发板选型表

注:米尔提供批量的型号定制,以满足客户的资源及成本要求。请联系米尔的销售。



6.3.开发板包装清单

项目	数量
板卡	核心板一片,底板一片,两者组装在一起
资料	QSG 快速使用手册一份
线材	USB 转 TTL 线一条
电源	12V/2A 电源及配件一个

表 6-3 开发板包装清单

6.4. 选配模块

项目	说明	
 百 / 仏 기	MY-CAM011B DVP接口摄像头模块	
摄像头 	MY-CAM003M MIPI 接口摄像头模块	
液晶屏 MY-LVDS070C 液晶模块, 7寸 LVDS 接口		
有线通信接口模块	MY-WiredCom,树莓派接口形式,支持 RS232/RS485/CAN	
5G 模块	移远 RM500Q	
WIFI/BT 模块	MY-WF005S	

表 6-4 选配模块清单